

IE-SP-007

1 適用範圍

- 1.1 本規範適用於RTT系列無鉛、無鹵素符合RoHS條款的厚膜晶片電阻器。
- 1.2 該產品應用於一般電子用途。

2 型別名稱

| (何 | RTT P | <u>02</u> | | 100 | لِّم | <u>™</u> |
|----|-------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| | 型別 | 尺寸 | | 電阻值 | 容差 | 包裝型式(請參閱 IE-SP-054) |
| | RTT 系列 厚膜晶片電阻器 | 01(0201) 02(0402) 03(0603) 05(0805) 06(1206) 12(1210) 18(1812) 20(2010) 25(2512) | 2% 5% (3-碼) | EX. 10Ω=100 4.7Ω=4R7 JUMPER=000 | B = ± 0.1% D= ± 0.5% F= ± 1% | Q1: 1 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs QE: 1 mm Pitch Carrier Tape 150000 pcs TH: 2 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs H0: 2 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs H1: 2 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs H2: 2 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs H3: 2 mm Pitch Carrier Tape 30000 pcs H4: 2 mm Pitch Carrier Tape 40000 pcs H5: 2 mm Pitch Carrier Tape 50000 pcs |
| | | | 0.1% 0.5% 1% (4-碼) | EX. 10.2Ω=10R2 10KΩ=1002 JUMPER=0000 | G=± 2% J=± 5% | F=± 1% G=± 2% |

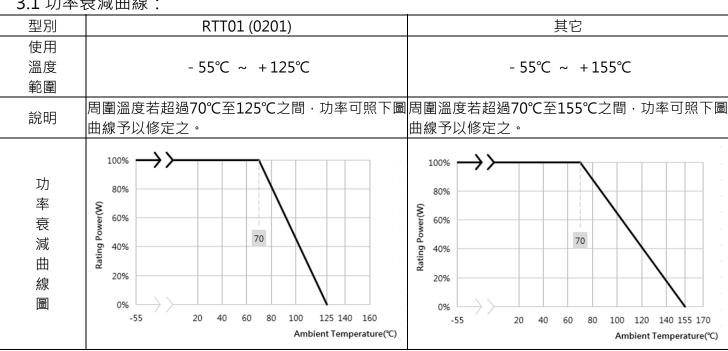


IE-SP-007

3 規格表

| 型別 | 額定 | 最高額定電壓 | 定 過負荷 | T.C.R (ppm/°C) | ·—·-·· | | | | JUMPER (0Ω) 額定電流 | | JUMPER (0Ω) 阻值 | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------|---------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------|------|---------------------|--|----------|----------|
| | 切 牵 | | | 溫度係數 | B(±0.1%) | D(±0.5%) | F(±1%) | G(±2%) \ J(±5%) | J | F | J | F | | | | | | |
| | | | | | E-24 \ E-96 | E-24 · E-96 | E-24 · E-96 | E-24 | (±5%) | (±1%) | (±5%) | (±1%) | | | | | | |
| RTT01 | 1 —W 1 2 | | 50V | -200 +400 | | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | 0.5A | 0.65A | 50r | | | | | | | |
| (0201) | 20 | | | | | | ±200 | 47Ω≤R≤1MΩ | 10Ω≤R≤10MΩ | 10Ω≤R≤10MΩ | 10Ω≤R≤10MΩ | | | MAX. | | | | |
| RTT02 | _1_w | EOV/ | 100V | ±100 | 20Ω≤R≤1MΩ | 10Ω≤R≤1MΩ | 10Ω≤R≤22MΩ | 10Ω≤R≤22MΩ | 1 / | 1.5A | 50mΩ | $35 \text{m}\Omega$ | | | | | | |
| (0402) | 16 | 50V | 1007 | ±200 | | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | 1A | 1.5A | MAX. M | MAX. | | | | | | |
| RTT03 | 1 W | 1_\(\dagger\) | 75)/ | 75)/ | 75\/ | 150V | ±100 | 100Ω≤R≤1MΩ | 10Ω≤R≤1MΩ | 10Ω≤R≤22MΩ | 10Ω≤R≤22MΩ | 1A | 2A | 50mΩ | $35 \text{m}\Omega$ | | | |
| (0603) | | 75V | 1500 | ±200 | | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | IA | ZA | MAX. | MAX. | | | | | | |
| RTT05 | 1 8 | 150V |)V 300V | ±100 | 100Ω≤R≤1.5MΩ | 10Ω≤R≤10MΩ | 10Ω≤R≤27MΩ | 10Ω≤R≤27MΩ | 2A | 2.5A | 50mΩ | $35 \text{m}\Omega$ | | | | | | |
| (0805) | | | | ±200 | | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | ZA | 2.5A | MAX. | MAX. | | | | | | |
| RTT06 | TT06 1 W | | 400V | ±100 | 10Ω≤R≤1MΩ | 10Ω≤R≤10MΩ | 10Ω≤R≤27MΩ | 10Ω≤R≤27MΩ | 2A | 3.5A | 50mΩ | $35 \text{m}\Omega$ | | | | | | |
| (1206) | 4 ** | 200V | 400 V | ±200 | 3Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | ZA | 3.5A | MAX. | MAX. | | | | | | |
| RTT12 | $\frac{1}{2}$ W 200V | V 200V | 2001 | N 200V | 2001 | 400V | ±100 | 100Ω≤R≤1MΩ | 10Ω≤R≤10MΩ | 10Ω≤R≤27MΩ | 10Ω≤R≤27MΩ | 2A | 4A | 50mΩ | $35 \text{m}\Omega$ | | | |
| (1210) | | | 4000 | ±200 | | | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | ZA | 4A | MAX. | MAX. | | | | | | |
| RTT18 | _3_w | V 200V | 200V | 200V | 200V | 400V | ±100 | 100Ω≤R≤1MΩ | 10Ω≤R≤10MΩ | 10Ω≤R≤20MΩ | 10Ω≤R≤20MΩ | 2A | 5A | 50mΩ | $35 \text{m}\Omega$ | | | |
| (1812) | 4 ** | | | | | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200V | 400 0 | ±200 | | | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω |
| RTT20 | <u>3</u> w | / 200V | 400V | ±100 | 100Ω≤R≤1MΩ | 10Ω≤R≤10MΩ | 10Ω≤R≤20MΩ | 10Ω≤R≤20MΩ | 2A | 5A | 50mΩ | $35 \text{m}\Omega$ | | | | | | |
| (2010) | W | | 4000 | ±200 | | | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | ZA | ЭА | MAX. | MAX. | | | | | | |
| RTT25 | 1W | 2001/ | 400V | ±100 | 100Ω≤R≤1MΩ | 10Ω≤R≤10MΩ | 10Ω≤R≤20MΩ | 10Ω≤R≤20MΩ | 2A | 7A | 50mΩ | $35 \text{m}\Omega$ | | | | | | |
| (2512) | TAA | W 200V | 4007 | ±200 | | | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω | ZA | /A | MAX. | MAX. | | | | | | |
| | 使用溫 | 度範圍 | | | | -55℃ ~ +1 | 155°C (0201:-55° | C ~ +125°C) | | | | | | | | | | |

3.1 功率衰減曲線:





IE-SP-007

3.2 額定電壓:

對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電壓。

可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電壓時,則以最高額定電壓為其額定電壓。

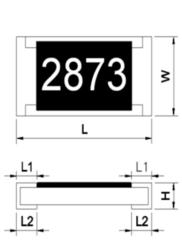
$$E = \sqrt{R \times P}$$

E=額定電壓(V)

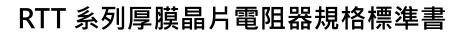
 $R=公稱阻值(\Omega)$

P=額定功率(W)

4 尺寸



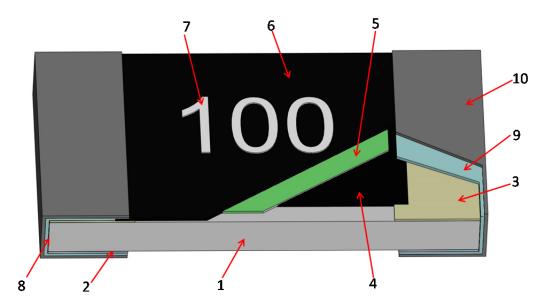
| | | | | | Į | Unit: : mm |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Dimension | | | | | |
| | | L | W | Н | L1 | L2 |
| Туре | Size Code | | | | | |
| RTT01 | 0201 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.23±0.03 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
| RTT02 | 0402 | 1.00±0.10 | 0.50±0.05 | 0.30±0.05 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
| RTT03 | 0603 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.30±0.15 | 0.30±0.15 |
| RTT05 | 0805 | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.50±0.10 | 0.35±0.20 | 0.35±0.15 |
| RTT06 | 1206 | 3.05±0.10 | 1.55±0.10 | 0.50±0.10 | 0.45±0.20 | 0.35±0.15 |
| RTT18 | 1812 | 4.40±0.20 | 3.15±0.20 | 0.47±0.20 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
| RTT12 | 1210 | 3.05±0.10 | 2.55±0.10 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
| RTT20 | 2010 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
| RTT25 | 2512 | 6.30±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |





IE-SP-007

5 結構圖



| 1 | 陶瓷基板 | Ceramic substrate | 6 | 2nd 保護層 | 2nd Protective coating |
|---|---------|------------------------|----|---------|--------------------------|
| 2 | 背面內部電極 | Bottom inner electrode | 7 | 字碼 | Marking |
| 3 | 正面內部電極 | Top inner electrode | 8 | 側面內部電極 | Terminal inner electrode |
| 4 | 電阻層 | Resistive layer | 9 | Ni 層電鍍 | Ni plating |
| 5 | 1st 保護層 | 1st Protective coating | 10 | Sn 層電鍍 | Sn plating |



IE-SP-007

6 信賴性試驗項目

6.1 電氣性能試驗(Electrical Performance Test)

| ltem | Conditions | Specifications規格 | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|--------|--|--|
| 項目 | 條件 | Resistors | Jumper | | |
| Temperature | TCR(ppm/°C)= $\frac{(R2-R1)}{R1(T2-T1)} \times 10^6$ R1:室溫下量測之阻值(Ω) | 參考3.規格表 | NA | | |
| Coefficient of | R2:-55℃或+125℃下量測之阻值(Ω) | | | | |
| Resistance | T1:室溫之溫度(°C) | | | | |
| 溫度係數 | T2:-55°C或+125°C之温度(°C)。 | | | | |
| | 依據 JIS-C5201-1 4.8 | | | | |
| | 施加2.5倍的額定電壓5秒,靜置30分鐘以上再量測阻值變 | 0.1% \ 0.5% \ 1%:△R=±1.0% | | | |
| Short Time | 化率。 | 2% \ 5%:△R=±2.0% | 規格表 | | |
| Overload | (額定電壓值請參考 3.規格表) | | | | |
| 短時間過負荷 | 依據 JIS-C5201-1 4.13 | | | | |
| | 將晶片電阻置於治具上·在正負極施加100 VDC一分鐘後 | <u>≥</u> 10 ⁹ Ω | | | |
| | 測量電極與保護層及電極與基板(底材)之絕緣電阻值。 | | | | |
| | 依據 JIS-C5201-1 4.6 | | | | |
| Insulation Resistance 絕緣電阻試驗 | A 測試點 電阻背面 B 測試點 B 測試點 B 測試點 B 测試點 B 测試點 B 测试點 B 测试點 B 测试點 B N B N B N B N B N B N B N B N B N B | | | | |
| Dielectric | 將晶片電阻置於治具上·在正、負極施加VAC (參考下列) | 無短路或燒毀現象。 | | | |
| Withstand | | | | | |
| Voltage | RTT01、02、03用300 VAC - 分鐘 | | | | |
| 絕緣耐電壓 | 依據 JIS-C5201-1 4.7 | | | | |
| | 置於恆溫箱中·施加2.5倍額定電壓·1秒ON·25秒OFF· | △R=±5.0% | 參考3. | | |
| | 計10000+400/-0次後取出靜置60分鐘後量測阻值變化量。 | | 規格表 | | |
| Intermittent | Jumper:施加最高過負荷電流 | | | | |
| Overload | 型別 RTT01 RTT02 RTT03 RTT05 RTT06 RTT12 RTT18(RTT20 RTT25 | | | | |
| 斷續過負荷 | Jumper (0201) (0402) (0603) (0805) (1206) (1210) 1812) (010) (2512) ±5% 1.25A 2.5A 2.5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A | | | | |
| | ±1% 1.63A 3.75A 5A 6.25A 8.75A 10A 12.5A 12.5A 17.5A | | | | |
| | 依據 JIS-C5201-1 4.13 | | | | |



IE-SP-007

6.2 機械性能試驗(Mechanical Performance Test)

| ltem | Conditions | Specifications規格 | | | |
|----------------|--|-----------------------|--------|--|--|
| 項目 | 條件 | Resistors | Jumper | | |
| | 測試項目一:將電阻焊在電路板上,在電阻背面施以5N的力 | 項目一:外觀無損傷,無側導脫落。 | 及本體斷裂發 | | |
| Terminal | 量持續10 sec後·檢查側導體外觀。 | 生。 | | | |
| Strength | (RTT01:3N) | 項目二:RTT01≧3N | | | |
| 端電極 | 測試項目二:將電阻焊在電路板上,逐漸施加力量於電阻背 | 其它 ≥5N | | | |
| 拉力測試 | 面,測試端電極最大剝離強度。 | | | | |
| | 依據 JIS-C5201-1 4.16 | | | | |
| Resistance to | 浸於20~25℃異丙醇溶劑中5±0.5分鐘後,取出靜置48 hr | | 參考3. | | |
| Solvent | 以上,再量測阻值變化率。 | 型別 RTT01 其他 | 規格表 | | |
| 耐溶劑性 | | △R% △R=±1.0% △R=±0.5% | | | |
| 試驗 | 依據 JIS-C5201-1 4.29 | | | | |
| | 前處理:將晶片電阻放置於PCT試驗機內,在溫度105℃、濕 | 導體吃錫面積應大於95%。 | | | |
| | 度100%及氣壓1.22×10 ⁵ pa的飽和條件下進行4小時的老 | | | | |
| Solderability | 化測試·取出後靜置於室溫下2小時。 | | | | |
| 焊錫性 | 測試方法:將電阻浸於235±5℃之爐中2秒後取出置於顯微 | | | | |
| | 鏡下觀察焊錫面積。 | | | | |
| | 依據 JIS-C5201-1 4.17 | | | | |
| | ●測試項目一(焊錫爐測試): | 試驗項目一: | 參考3. | | |
| | 浸於260+5/-0℃之錫爐中10 秒+1/-0、取出靜置60分鐘 | △R%=±1.0% | 規格表 | | |
| | 以上,再量測阻值變化率。 | | | | |
| | ●測試項目二(焊鍚爐測試): | 試驗項目二: | | | |
| Resistance to | 浸於260+5/-0℃之錫爐中30+1/-0秒,取出後洗淨。置 | (1).導體吃錫面積應大於95%。 | | | |
| Soldering Heat | 於顯微鏡下觀察焊錫面積。 | (2).在電極邊緣處不應見到下層的 | | | |
| 抗焊錫熱 | ●測試項目三(電烙鐵試驗): | 物質(例如白基板)。 | | | |
| リレベナ 単分 が代 | 加熱溫度:350±10℃ | | | | |
| | 烙鐵加熱時間:3+1/-0 sec. | 試驗項目三: | | | |
| | 取電鉻鐵加熱於電極兩端後,取出靜置60鐘以上,再量測 | △R%=±1.0% | | | |
| | 阻值變化率。 | | | | |
| | 依據 JIS-C5201-1 4.18 | | | | |



IE-SP-007

| Item | Conditions | Specifications規格 | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|--|
| 項目 | 條件 | Resistors | Jumper | |
| | ●彎折性測試 | △R%=±1.0% | 參考3. | |
| | 將晶片電阻焊於彎折性測試板中,置於彎折測試機上,在測 | | 規格表 | |
| | 試板中央施力下壓・於負荷下量測阻值變化率。 | | | |
| | 下壓深度(D): RTT02、03、05=5mm | | | |
| | RTT01 \ 06 \ 12=3mm | | | |
| | RTT18 \ 20 \ 25=2mm | | | |
| Joint Strength of Solder 焊錫粘合強度 | Solder Supporting jig Chip resistor | | | |
| | Pressurtze OHM Meter | | | |
| | 依據JIS-C5201-1 4.33 | | | |

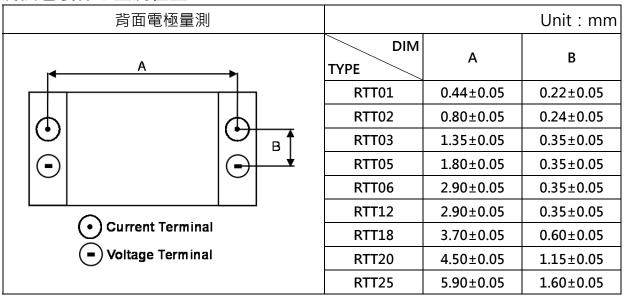


IE-SP-007

6.3 環境試驗(Environmental Test)

| Item | Conditions 條件 | | | | | Specifications規格 | | | |
|---------------|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|--|
| 項目 | | | | | | Res | istors | Jumper | |
| Resistance | 置於155 | 5±5℃之烤箱中1000+48/-0 hı | rs,取出靜置 | 1 hr以 | 0.1% \ | 0.5%、1 | L%:△R%=±1.0% | 參考3. | |
| | 上再量源 | 則阻值變化率。 | | | | 2% \ 5 | 5%:△R%=±2.0% | 規格表 | |
| to Dry Heat | PS:RTT(|)1置於125±3℃中。 | | | | | | | |
| 耐熱性試驗 | 依據 JIS | S-C5201-1 4.25 | | | | | | | |
| | 將晶片電 | 国阻置入冷熱沖撃機中,溫度為 | 3-55℃ 15分 | 鐘, | 0.1% \ | 0.5% \ 1 | L%:△R%=±0.5% | 參考3. | |
| | +125°C | 15分鐘,共計循環300次後取 | 出,靜置60分 | } 鐘再量 | | 2% \ 5 | 5%:△R%=±1.0% | 規格表 | |
| | 測阻值變 | 變化率。 | | | | | | | |
| Thermal Shock | | 測試條件 | | | | | | | |
| 冷熱沖擊 | | 最低温度 | -55±5℃ | | | | | | |
| | | 最高溫度 | 125±5℃ | | | | | | |
| | | 溫度保留時間 | 15分 | | | | | | |
| | 依據 M | IL-STD 202 Method 107 | | ! | | | | | |
| | 置於溫原 | 度40±2℃相對濕度90~95%恆剂 | 温恆濕槽中 , | 並施加 | 型別 | RTT01 | 其他型別 | 參考3. | |
| | 額定電腦 | 壓,90分鐘ON,30分鐘OFF, | 共1,000 hrs耳 | 以出靜置 | 1% | : | 0.1% \ 0.5% \ 1%: | 規格表 | |
| | 60分鐘』 | 以上再量測阻值變化率。 | | | 範圍 | | △R%=±0.5% | | |
| 耐濕負荷 | 依據 JIS | S-C5201-1 4.24 | | | 5% | | 2% \ 5%: △R%=±2.0% | | |
| | 罢於70 | | 00公给ON | 20公结 | | | <u> </u> | 參考3. | |
| | | | | | 型別 1% | RTT01 | 其他型別 0.1%、0.5%、1%: | | |
| Load Life | | ţ1,000 hrs. 取出靜置60分鐘以 | (工丹里測阻) | 且愛化 | △ R ^c | • | △R%=±0.5% | 規格表 | |
| 負荷壽命 | 率。 | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | | | 範圍 5% | | 2% ` 5%: | | |
| | 伙據 13 | S-C5201-1 4.25 | | | △R | %=±3.0% | △R%=±2.0% | | |

7 阻值測試包裝標準量測位置



IE-SP-007

8 鍍層厚度

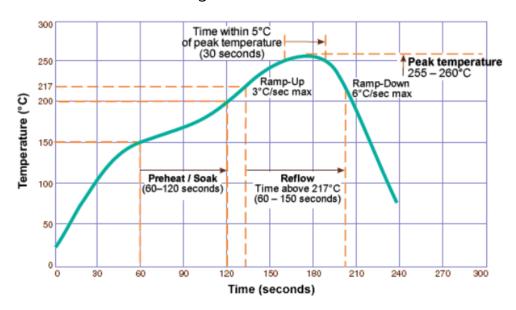
8.1 鎳層(Ni)厚度: <u>≥</u>2μm

8.2 純錫層(Tin): ≧3μm

8.3 電鍍純錫為霧錫。

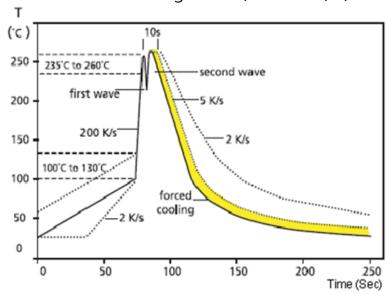
9 技術應用說明(此為建議,請客戶使用時依實際應用作調整)

- 9.1 建議焊錫條件:
 - (a) Lead Free IR Reflow Soldering Profile (符合J-STD-020)



備註:零件最高耐溫260+5/-0℃,10秒。

(b) Lead Free Double-Wave Soldering Profile(適用0603(含)以上之產品)



(c) 烙鐵焊錫方法:350±10°C 3秒之內。



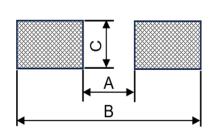


IE-SP-007

9.2 建議 Land Pattern Design (For Reflow Soldering):

當元件被焊接時,焊接後的電阻值根據焊接區域的大小和焊接量的不同而稍有變化。設計電路時,有必要考慮其電阻值降低或增加的影響。





| DIM TYPE | Α | В | С |
|-------------|-----|-----|-----|
| RTT01 | 0.3 | 1.0 | 0.4 |
| RTT02 | 0.5 | 1.5 | 0.6 |
| RTT03 | 0.8 | 2.1 | 0.9 |
| RTT05 | 1.2 | 3.0 | 1.3 |
| RTT06 | 2.2 | 4.2 | 1.6 |
| RTT12 | 2.2 | 4.2 | 2.8 |
| RTT18 | 3.1 | 5.9 | 3.0 |
| RTT20 | 3.5 | 6.1 | 2.8 |
| RTT25 | 3.8 | 8.0 | 3.5 |

9.3 使用環境注意事項:

此規格產品為一般電子用途,RALEC將不為任何使用在特殊環境下,使用此規格產品導致之損害、費用或損失負責,如有其他應用需與RALEC進行確認是否適用。

若客戶端有意於特殊環境或狀態下使用本公司產品(包括但不限於如下所示),則需針對下 列或其他運用環境各別承認產品特性及信賴性。

- (a) 運用於高溫高濕之環境;
- (b)於接觸海風或運用於其他腐蝕性氣體之環境:Cl2、H2S、NH3、SO2及NO2;
- (c) 於非驗證過液體中使用,包括水、油、化學品及有機溶劑;
- (d)使用非驗證過之樹脂或其他塗層材料來封合或塗層本公司產品;
- (e) 於焊錫後之清洗,需使用水溶性清潔劑清洗殘留於產品助焊劑,縱然使用免洗助焊劑仍建議清洗。

9.4 暫態過載注意事項:

本產品可能對於暫態過載而導致產品之功能喪失,請注意您的製造過程和保存,避免發生高於產品規格之暫態電流施加在產品上。



IE-SP-007

9.5 作業及處理注意事項:

- (a) 作業時需確保電阻邊緣及保護層免於機械應力破壞。
- (b) 印刷電路板(PCB)分開或固定在支撐體上時應小心操作,因為印刷電路板(PCB) 安裝的彎曲會對電阻器造成機械應力。
- (c) 電阻需於規格中額定功率範圍內使用,尤其當功率超出額定值時,將會負載在電阻上,有可能因溫度上升造成機器損害。
- (d) 若電阻將可能接受大量負載(脈衝波)衝擊時,必須於使用前設置作業環境。
- (e) 使用該產品時請在貴司實裝狀態下評估及確認,充分考慮故障安全設計,確保系統上的安全性。

10 儲存及搬運條件

- 10.1 在儲存環境25±5℃、60±15%之條件下可儲存二年。
- 10.2 存儲時請避開如下惡劣環境,以免影響產品性能及焊錫連接性:海風、Cl2、H2S、NH3、SO2及NO2等腐蝕性氣體的場所,陽光直射、結露場所。
- 10.3 產品搬運、存儲時請保證箱體的正確朝向,嚴禁摔落、擠壓箱體,否則可能造成產品 電極或本體受損。

11 電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示(外銷中國大陸)



12 附件:

12.1 文件修訂記錄表(QA-QR-027)



IE-SP-007

法律免責聲明

RALEC 及其經銷商與代理商(以下統稱"RALEC")不因任何產品相關資訊(包括但不限於產品規格、資料、圖片和圖表)中包含的任何錯誤、不正確或不完整,而承擔任何責任。RALEC可能隨時對產品相關資訊進行更改、修訂或改善,恕不另行通知。

RALEC 對於其產品使用於特殊目的之適用性或其任何產品的持續生產不為任何承諾、保證及/或擔保。在法律准許的最大程度內,RALEC 不承擔任何下述之責任:(i)因應用或使用任何RALEC 產品而產生之任何及所有責任,(ii)任何及所有責任,包括但不限於因 RALEC 產品所造成或與 RALEC 產品相關的利潤損失或是直接損害、間接損害、特別損害、懲罰性損害、衍生性損害或附帶性損害,及(iii)任何及所有默示保證,包括產品適用於特殊用途、非侵權、及適銷性。

RALEC 將此產品定義為一般電子用途,不適用於任何車用電子、醫療救生或維生設備,亦不適用於當 RALEC 產品故障時,可能造成人員傷亡之任何應用上。 RALEC 所提供的任何及所有的關於產品應用上的技術建議,均為無償提供,RALEC 對於採用該等技術建議及可獲取的結果,不承擔任何義務及責任,採用該等建議之所有風險,概由買方承擔。買方將 RALEC 產品使用於與其他材料或原料結合、或實施於其任何製程中之組合,所產生的所有風險及責任,概由買方承擔,不論 RALEC 對於產品的使用給予任何口頭或書面的技術説明、建議或其他。

此處所提供之資訊僅為說明產品規格,產品未變更時,RALEC 保有修改此內容不另行通知之所有權利,任何產品變更將會以 ECN 公布。